

OMNIMATE Data – RJ45 konektory RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Produktová řada zahrnuje následující konstrukce:

- 90°, ležící (horizontální) a 180°, stojící (vertikální)
- blokování nahoru / blokování dolů
- Procesy pájení THT, THR nebo SMD
- Široká řada různých typů konstrukce, včetně integrovaných kontrol LED a stíněných kontaktů
- Kategorie výkonu Cat. 3 až Cat. 6
- Baleno na podnosu (TY) nebo na roli (pás na cívce, RL)

Vlastnosti a výhody

- Rozšířený teplotní rozsah -40 °C až +85 °C pro maximální výkon
- Vyztuženo vrstvou zlata ((30μ") pro lepší ochranu proti korozi
- Odstup nejméně 3 mm zajišťuje perfektní výsledek pájení

Všeobecné objednací údaje

Typ	RJ45C6 R1V 3.2N4N TY
Objednací číslo	2634590000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, RJ45 konektory, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 180°, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4050118651270
Mnž.	160 ks

OMNIMATE Data – RJ45 konektory RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	7,475 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Balení

Délka VPE	0,315 m	Šířka VPE	0,195 m
Výška VPE	0,065 m		

Specifikace systému

Cykly zapojování	750	Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Plocha stínění	poniklované	Počet pólů	8
Skupina produktů	OMNIMATE Data – RJ45 konektory	Stupeň krytí	IP20
Výstupní tvarovka	180°		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 9,1	27-44-04-02	eClass 9.0	27-44-04-02

Osvědčení

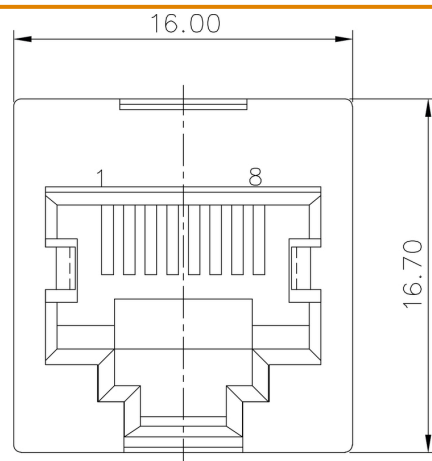
ROHS	Shoda
------	-------

OMNIMATE Data – RJ45 konektory RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

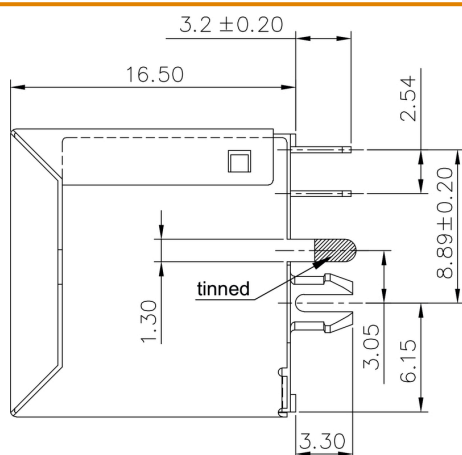
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

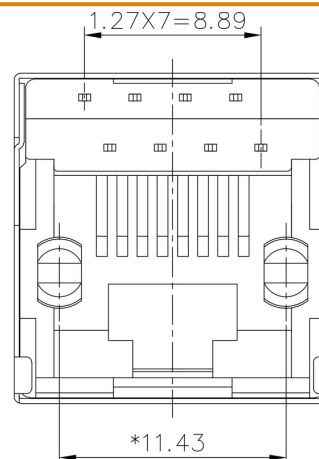
Rozměrový výkres



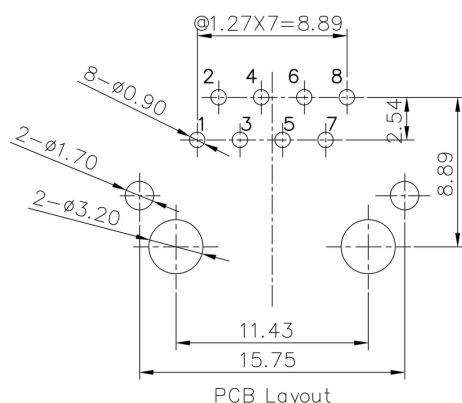
Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



DPS design

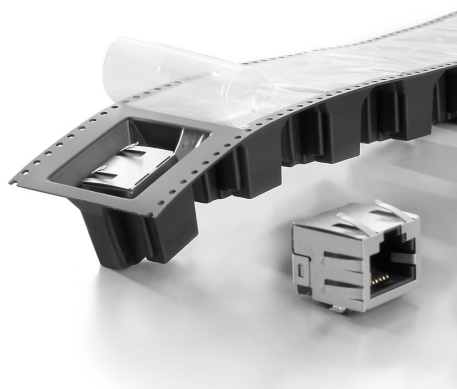


OMNIMATE Data – RJ45 konektory RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

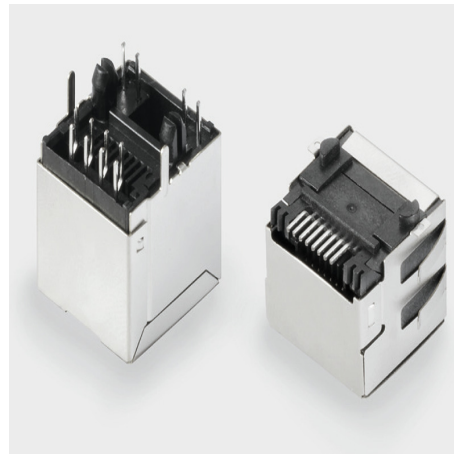
Výhoda produktu



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Výhoda produktu

Výhoda produktu



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Datum vytvoření 17. července 2019 21:25:54 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

OMNIMATE Data – RJ45 konektory

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Legenda

RJ45	G1	R1	U1	U2	E4	G6/GY	TY	
							Packaging	TY RL
							LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N
							Contact surface thickness	4
							EMI tabs (ground fingers)	E N
							Solder Pin length	3.2 1.6 D
							Direction, latch style	U D V Y
							Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...
							Assembly on PCB	R S T
							Performance Category	C5 C6 C6A C5e M G1 G10 U NP MP+

Tray in box (manual assembly)
Tape on Reel (automated assembly)

Yellow/Green
Green/Yellow (standard)
Green-Yellow/Green-Yellow
Orange/Green
Red/Orange
... (further combinations possible) without LED

1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"

E = with EMI tabs
N = without EMI tabs

3.2 mm
1.6 mm
SMD

Horizontal (90°, side entry), latch up
Horizontal (90°, side entry), latch down
Vertical (180°, top entry)
Diagonal (45°), latch up

1 Port
multi ports side by side, Multiport
multi ports about each other, Multilevel

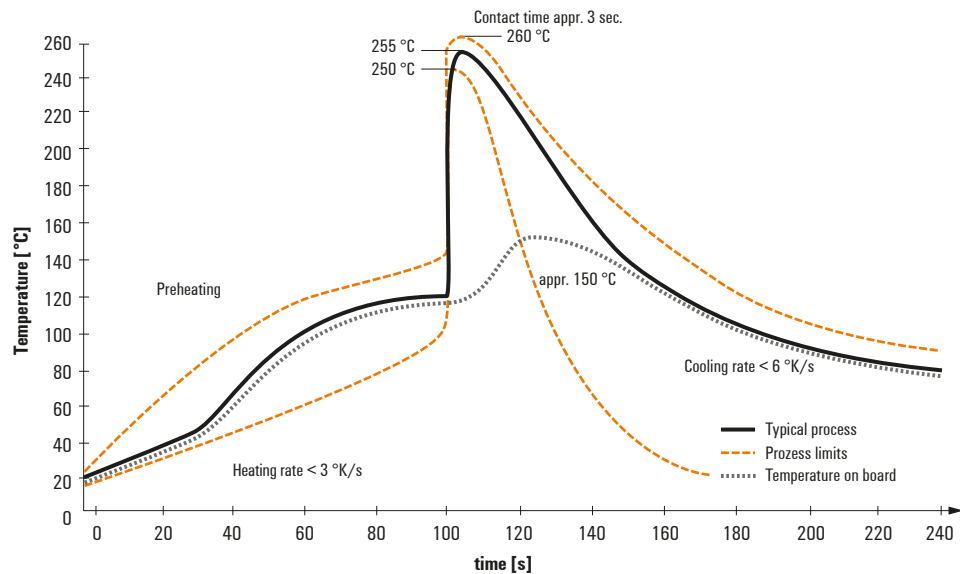
Through Hole Reflow - THR
Soldering process: Wave or Reflow soldering
Surface Mount Technology - SMT
Soldering process: Reflow soldering
Through Hole Technology - THT
Soldering process: Wave

Category 5
Category 6
Category 6A
Category 5e
10/100 Mbit
10/100/1000 Mbit
10 Gbit
Unshielded
10/100 Mbit with POE
10/100 Mbit with POE+

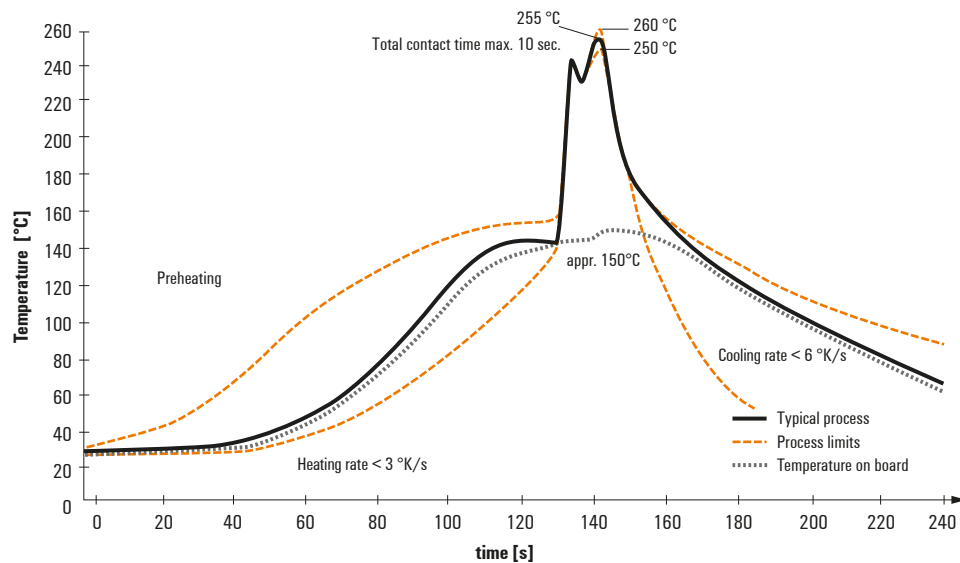
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.